

# MUP Series

A new standard process of glass wafer cutting

ガラスウエハ切断プロセスの次世代スタンダード

Wheel scribing at high-speed, dry process, giving substantial productivity improvement for glass wafer based Semiconductors

ガラスウエハベースの半導体基板を高速度のドライプロセスで分断加工することにより、大幅な生産性向上を実現しました。



The outside appearance and specifications are subject to change without notice.

外観、仕様は予告なしに変更になることがあります。

# V-motion Separator for Semiconductors

半導体部品向け V-motion Separator MUP シリーズ

## MUP Series (MUP701/801SL&BLU)

### MUP Specifications

MODEL		MUP-SL	MUP-BLU
Process	プロセス	Wheel Scribe	V-motion Break
Wafer Size	対応ウエハサイズ	8"/12"φ	
Wafer Thickness	対応ウエハ厚み	t0.2mm~1.5mm (TBD)	
Process Speed	加工スピード	Scribe Scan at Max.500mm/sec.	Break shot at < 1sec./shot
Dimensions	寸法	W2,200×D1,800×H1,600 (mm)	W2,460×D1,800×H1,600 (mm)
Weight	重量	Approx.2,500kg	Approx.2,700kg

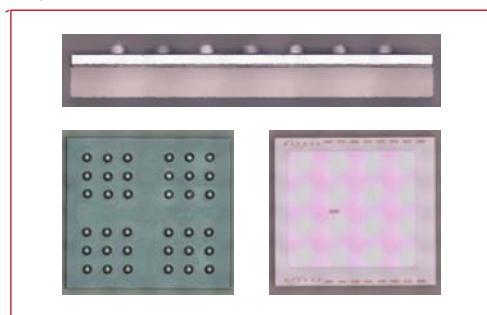
### Applications

CMOS Image Sensor, Other devices (Glass wafer based)

[Example] CIS wafer (separated into chips)



overall view



chip enlarged view

### Contact

[www.mitsuboshidiamond.com](http://www.mitsuboshidiamond.com)

※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners.

※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※The specs are subject to change without prior notice.

※記載された仕様は予告なく変更することがあります。